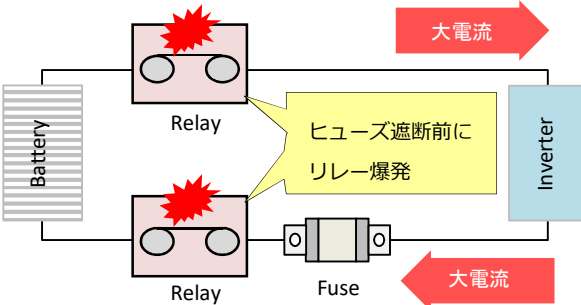
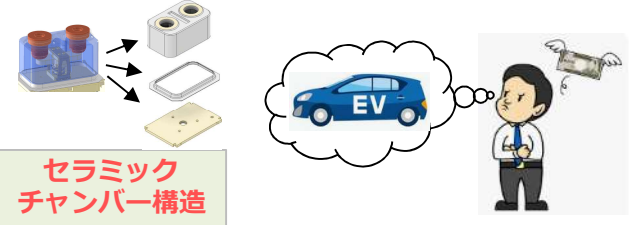
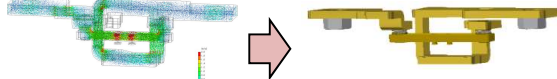
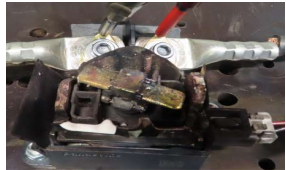
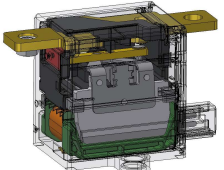


展示No	(宮城県)	提案区分	☐ 樹脂成形	☐ ゴム製品	☒ 電気・電子部品等	☐ 鋳造・鍛造等				
	02		☐ プレス加工	☐ 表面処理・熱処理	☐ 機械加工	☐ システム・ソフトウェア				
☐ その他()										
提案技術・製品名 軽量・高性能 高電圧DCリレー「ER250」										
企業名	EMデバイス(株)				資本金	1億円				
					従業員	2,480名				
所在地	宮城県白石市旭町7丁目1-1				本社所在地	宮城県白石市旭町7丁目1-1				
海外生産拠点	フィリピン									
主要取引先	【国内】(株)アイシン、(株)東海理化、他多数 【海外】Continental、Bosch、Lear、APTIV、他多数									
規格認証取得	ISO-9001、IATF-16949									
提案の狙い	☐ 新工法 ☐ 品質向上 ☒ 性能向上 ☐ 質感向上 ☐ 生産性向上 ☒ コストダウン ☒ 軽量化 ☐ 環境負荷 ☐ その他()									
適用可能な製品/分野	・電気自動車、燃料電池車、ハイブリッド車 ・DC急速充電器									
セールスポイント	・EMデバイス独自の接点構造採用により、世界一の短絡耐量:20kAを達成。 ・ノンセラミックチャンバーでのアーク制御技術開発による小型化/軽量化を実現。 ・耐衝撃性能/負荷性能の高性能化に伴う安全性の向上。									
提案技術・製品名の内容/特長										
従来技術・製品			提案技術・製品							
☐ 自社 ☒ 同業他社 ☐ その他()			ソリューション1: 短絡耐量の増強  困りごと1: 短絡電流でリレーが爆発 ・バッテリー大容量化 ・EV事故→短絡電流発生 短絡電流:増加傾向 困りごと2: 航続距離改善⇒軽量化 困りごと3: コストダウン  セラミックチャンバー構造				 【実証】短絡実験  ER250 短絡耐量 Max.20kA確保  他社製品 短絡電流 13kAで爆発 世界初 安全性能達成 ソリューション2,3: 軽量化、コストダウン  ノンセラミック チャンバー構造採用 ↓ 軽量化・コストダウン達成 ER250 その他強み: 高性能 ・耐衝撃性能 Close/Open: 100G 確保 ・負荷遮断性能 450VDC/1800A対応 ・負荷突入性能 450VDC/400A対応			
開発進度(10月現在)	☐ アイデア段階 ☐ 試作/実験段階 ☒ 開発完了段階 ☐ 製品化完了段階									
従来との比較 優位性数値割合	品質向上	性能向上	質感向上	生産性向上	コストダウン	軽量化	その他()			
	-	+250%	-	-	△10%	△5%				
連絡担当者	【所属・役職】xEV事業推進部門・シニアマネージャー									
URL	https://www.em-devices.com/			Email yoshiyuki.shibuta@em-devices.com						
TEL	(0224)26-6189			FAX (0224)26-6447						